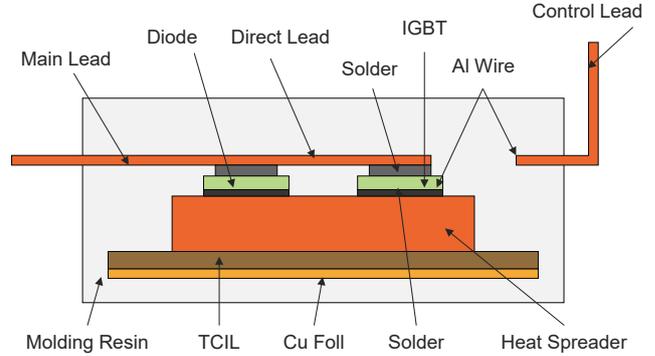


# CMC AISiC 散热片

RoHS Compliant

## 一般说明 General Description

陶瓷基复合材料，用于提升电子元件的热导率与散热效率。



可作为铜 (Cu) 或钼铜 (Mo-Cu) 的替代材料。

## 产品特性 Feature

- 优异的高温加工稳定性
- 经热循环与可焊性测试后无翘曲现象
- 低热膨胀系数与高热导率
- 重量低于铜
- 可实现超薄厚度且不易翘曲，最薄可达 1mm
- 通过抗振动测试
- 经热循环测试后使用寿命优于铜

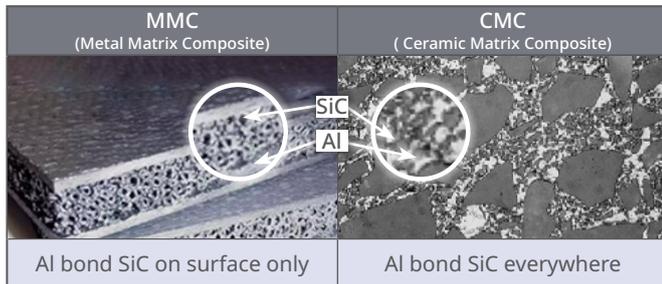
## 产品规格 Specification

Properties	Unit	CMC AISiC
导热系数 Thermal Conductivity	W/m·K	150~180 (Based on different thickness)
标准品尺寸 Standard Product Dimensions L × W × H	mm	187x137x4.8
		140x99.5x4.65
		107x62x3.25
		39.5x39.5x1.6
热膨胀系数 Coefficient of Thermal Expansion, CTE	PPM/K	7~10
刚性 Strength	MPa	>300
表面处理 Plating	μm	Ni --- 3
密度 Density	g/cm <sup>3</sup>	2.6~3.0

※ 尺寸可定制。Product dimensions can be customized.

※ 产品出货前，皆依规范进行表面镀镍处理。All products undergo surface nickel plating in accordance with specifications prior to shipment.

## CMC AISiC 与 MMC 材料比较：



高柏科技股份有限公司 T-Global Techonology Co., Ltd.

330058 桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No. 33, Ln. 50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan  
 T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20  
20251218



注意：本技术数据表中的信息系高柏团队基于研究与测试所得出的最优数据。数据表所列参数仅为典型值，并不代表每一批次材料均进行测试。如有规格变更，恕不另行通知；对产品功能无影响的保护膜及离型纸，若无特殊要求，均以高柏默认标准为准。由于实际使用条件多种多样，超出我方控制范围，故本数据表中的建议不构成任何担保或法律责任。用户应根据实际应用需求，自行进行测试，以确认本产品在特定环境中的适用性。本产品销售不附带任何明示或暗示的适用性声明，不构成其适用于特定用途的保证。产品品质标准应以高柏与客户确认的发票、报价单或订单为准。我方不对用户基于本数据表延伸或修改内容而造成的结果承担任何责任，相关风险由用户自行承担。此外，本技术数据表所载信息不构成对现有用途、未来潜在专利冲突、工艺制造方法或产品使用建议的任何陈述或保证。